PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-155796

(43)Date of publication of application : 18.06.1996

(51)Int.CI.

B230 17/24

G01B 15/00

H05K 3/00

(21)Application number : 06-296852

(71)Applicant : SEIKOSHA CO LTD

(22)Date of filing:

30.11.1994

(72)Inventor: KATO SHINICHI

ARAKI MASATOSHI

(54) HOLE BORING METHOD USING X-RAY AND ITS METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To correctly obtain the drilling position of a printed circuit board in the drilling using the X-ray. CONSTITUTION: A printed circuit board is irradiated with the X-ray from an X-ray irradiating means, the transmitted image of the identification mark provided on the printed circuit board is photographed (72) by an Xray camera, and this result is image processed to detect the center position of the mark (73). A drilling means is moved (74) so as to be opposite to this mark center position to achieve the drilling (75). Then, the identification and the hole are simultaneously photographed (76) and both positions are compared with each other (77). If both positions are deviated from each other, the corrective data are prepared based thereon. The images M, H of the identification mark and the hole are simultaneously photographed after the drilling, and the results are used as the corrective data. Because the deviation attributable to the movement of the work in the drilling operation is eliminated, drilling can be made at the correct position in the subsequent drilling operation.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.10.1996

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2985045

[Date of registration]

01.10.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAALla4.gDA408155796P1.h... 2003/07/08

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平8-155796

(43)公開日 平成8年(1996)6月18日

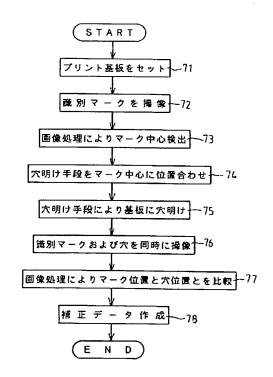
(51) Int. C1. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 3 Q	17/24	D			7. W. C. 1. 2. 7.
G 0 1 B	15/00	В			•
H 0 5 K	3/00	K			
		М			
	審查請求	未請求 請求	項の数 2 O	L	(全8頁)
(21)出願番号	特願平6-296852			(71)出願人	000002381
					株式会社精工舎
(22)出願口	平成6年(1994)11月30日				東京都中央区京橋2丁目6番21号
				(72)発明者	加藤 真一
					東京都墨田区太平四丁目1番1号 株式会社
					精工舎内
,				(72)発明者	荒木 正俊
					東京都墨田区太平四丁目1番1号 株式会社
					精工舎内
				(74)代理人	弁理士 松田 和子
			•		

(54) 【発明の名称】 X線を用いた穴明け方法及び X線穴明け装置

(57)【要約】

【目的】 X線を用いた穴明けにおいてプリント基板の 穴明け位置を正確に求められるようにする。

【構成】 X線照射手段からプリント基板にX線を照射 し、プリント基板に設けられた識別マークの透過像をX 線カメラ2によって撮像し (72)、この結果を画像処 理してマーク中心位置を検出する(73)。このマーク 中心位置に対向するように穴明け手段を移動させ(7 4)、穴明けを行なう(75)。その後で識別マークと 穴とを同時に撮像し (76)、両者の位置を比較する (77)。両者の位置にずれがあれば、それに基づいて 補正データを作成する (78)。識別マークと穴との画 像を穴明け後に同時に撮像してその結果を補正データと して用いるため、穴明け作業時におけるワークの移動に 起因するずれが解消されるので、以後の穴明け作業にお いて正確な位置に穴明けが可能になる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮像手段により未加工のプリント基板の 識別マークを撮像し、

上記撮像された画像を画像処理して上記識別マークの中 心位置を検出し、

穴明け手段を上記識別マークの中心位置に位置合わせ 1

上記穴明け手段によって上記プリント基板に穴明けを行 い

上記撮像手段によって上記識別マーク及び上記穴明けさ 10 れた穴を同時に撮像し、

穴明け後に同時に撮像して得た画像を画像処理して上記 識別マークの位置データと上記穴の位置データとを求 め

上記識別マークの位置データと上記穴の位置データとを 比較して補正データを作成し、

以降の穴明けにおいては、上記識別マークの中心位置を 上記補正データに基づく補正位置に上記穴明け手段を位 置合わせした後、穴明けを行うようにすることを特徴と する X 線を用いた穴明け方法。

【請求項2】 プリント基板に穴明けする穴明け手段と、上記プリント基板にX線を照射するX線照射手段と、上記プリント基板に設けてある識別マークの透過像及び上記穴明けされた穴を同時に撮像する撮像手段と、上記穴明け手段及び上記撮像手段を上記プリント基板に対し相対的に移動させるXYテーブル機構と、上記撮像手段により得られた画像を処理する画像処理装置と、上記画像処理装置から入力されるデータに基いて上記撮像手段及び上記穴明け手段を制御する中央処理装置とを備え、

上記中央処理装置には、上記穴明け後に同時に撮像した 上記識別マーク及び上記穴の位置データを比較してその ずれ量を算出する演算回路と、上記ずれ量を記憶する記 憶回路とが接続してあることを特徴とするX線穴明け装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、X線の透過像を撮像し、その撮像結果を画像処理した位置データに基づき穴明けを行う方法およびそのためのX線穴明け装置に関す 40 るものである。

[0002]

【従来の技術】プリント基板に穴明け加工を行う場合、 予め位置決め用の識別マークを設けておき、撮像手段により識別マークを撮像し、これを画像処理して中心位置を求め、この位置に穴明け手段により穴明けしている。 多層基板などにおいて、表面に穴明け位置の識別マークが露出していない場合には、通常の可視光線用カメラでは識別マークを撮像できない。そこで、X線照射手段及びX線カメラを採用し、X線の透過像を画像認識するこ とによりワークの識別マーク位置を検出することが行われている。X線穴明け装置は上記した手段を採用することによって多層基板に設けられた識別マークを基準にして穴明けを行う装置である。

【0003】 X線穴明け装置によって穴明けするための 位置決めは、テーブル上に載置されたワークに X線を照 射し、 X線カメラのゲインを調整したり、 X線の電圧・電流を調整することによりモニターしている。 上記の通りこの X線による識別マークの透過像を画像処理装置によって画像処理し、ドリル等の穴明け手段を画像処理によって求められた位置に X Y テーブルを使って移動させ、その位置に穴を明けている。

【0004】このような方法の一例として、特開平4-152048号には「多層プリント基板の基準マーク位置自動穴あけ方法」が開示されている。これは、マークの撮像を2回行うもので、一旦マーク中心位置を検出したら、その中心位置とX線カメラの画面の中心とが対向するようにX線カメラを移動した後、再度マークを撮像し画像処理によりマーク中心位置を求め直すものである。これにより、カメラによる撮像精度を向上させ、穴明けの高精度化を図るものである。

【0005】上記方法によると、確かにある程度の精度向上は見込めるものの、カメラ以外の要因による誤差は依然として含んでおり完全なものではない。

【0006】そこで、実際に穿設された穴の位置を確認して実際の誤差を求める方法が考えられる。すなわち、穴明け後に再度 X 線を照射して穴を撮像して画像処理し、その中心位置を算出する。そしてこれを、穴明け前に撮像して求めていた識別マークの中心位置と比較し30で、両者のずれに基づき補正データを作成するものである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記従来例では、穴明け前に検出した識別マークと穴明け後の識別マークとが同じ位置にある事を前提にして識別マークと穴との位置座標の比較が行われている。しかし、実際にはワークは穴明けによってわずかに移動して位置ずれを起こしていることが多いため、穴明け前の識別マークと穴明け後の穴との位置座標を比較しても正確な位置ずれを検出することができない問題があった。

【0008】そこで本発明の目的は、穴明け後に識別マークと穴明けした穴とをX線を用いて同時に撮像し、両者の位置座標からずれ量を算出し、補正データを得ることによって正確な位置への穴明けを可能にすることにある。

[0009]

多層基板などにおいて、表面に穴明け位置の識別マーク 【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するたが露出していない場合には、通常の可視光線用カメラで めに、本発明における X線を用いた穴明け方法は、撮像は識別マークを撮像できない。そこで、 X線照射手段及 手段により未加工のプリント基板の識別マークを撮像び X線カメラを採用し、 X線の透過像を画像認識するこ 50 し、撮像された画像を画像処理して識別マークの中心位

置を検出し、穴明け手段を識別マークの中心位置に位置合わせし、穴明け手段によって上記プリント基板に穴明けを行った後で、撮像手段によって識別マーク及び穴明けされた穴を同時に撮像し、この穴明け後に同時に撮像して得た画像を画像処理して識別マークの位置データと穴の位置データとを求め、両者を比較して補正データを作成するものであり、以降の穴明けにおいては、識別マークの中心位置を補正データに基づく補正位置に穴明け手段を位置合わせした後、穴明けを行うようにするものである。

【0010】そして上記方法を行なうためのX線穴明け装置は、プリント基板に穴明けする穴明け手段と、プリント基板にX線を照射するX線照射手段と、プリント基板に設けてある識別マークの透過像及び穴明けされた穴を同時に撮像する撮像手段と、穴明け手段及び撮像手段をプリント基板に対し相対的に移動させるXYテーブル機構と、撮像手段により得られる画像を処理する画像処理装置と、この画像処理装置とある一次の直接で見た。この画像処理装置とで開像した。この演算回路で算出されたずれ量を記憶する記憶回路とが接続されたものである。

[0011]

【作用】穴明け後における穴の位置データと穴明けの基準となった識別マークとを同時に撮像して得られたデータとを比較して補正データが作成されるため、カメラの精度に基づく誤差、穴明け手段の機械的な誤差などをすべて補正する値が求められる。また、中央処理装置に記憶回路を接続することによって、この補正データを記憶 30し、以後の穴明け作業における位置ずれの補正に利用可能になる。

[0012]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。図2、3は本実施例の全体構造を示しており、テーブル1の下方にX線の照射を受けて生じるワークの透過像を影像する撮像手段2と、穴明け手段3とが配設してある。テーブル1の上面には、ワークであるプリント基板4が搬送可能に載置されている。

【0013】テーブル1の上方には、所定の間隔をおい 40 て支持部材5が設けてあり、この支持部材5上にX線照射手段6が支持してある。支持部材5の下面には、保護カバー7が固着してある。保護カバー7の内部に、X線の通路やX線の洩れを防止するX線漏洩防止手段(図示略)が設けてある。

【0014】 X線照射手段6の下方には、ここから照射 される X線の通路8 a を構成する防護管8が連結してあ る。防護管8には X線の通路8 a を横切るようにシャッ タ9が設けてあり、このシャッタ9はシャッタシリンダ 10により進退駆動されて通路8 a を開閉する。防護管 50

8の外周に上下方向のガイド溝8 b が形成してある。

【0015】防護管8の下方には、通路8aに連通する X線の通路11aを有する保護筒11がワーク4に対し て接離可能に設けてある。この保護筒11は、ワーク4 をテーブル1上に押え付けるためのクランパを兼ねてお り、防護管8の外周に嵌合する筒体12の下端に固着し てある。 筒体 12の一部に、ガイド溝 8 b 内を摺動可能 なガイド13 a を内面に有するプレート13が一体的に 設けてある。支持部材5の下方には、简体12と平行し て保護筒11を下降させる手段としてのシリング14が 設けてある。シリンダ14は、筒体12に固着した連結 部材15を介して、シリンダロッド14aの伸張を筒体 12に伝達して保護筒11を下降させる。保護筒11に は図示しないブレーキ手段が備えられており、制御手段 を介して任意の位置で停止可能である。保護筒11の上 昇は、シリンダ14によって行われ、エアーダウンの時 に保護筒11が自重落下しないように連結部材15に戻 しばね16によって掛け止められている。

【0016】防護管8の両側には、センサ支持板17, 17が吊支してあり、これらの各センサ支持板17の下端部の内側にセンサ18,18が設けてある。センサ18はプリント基板4がX線の通路8a,11aの下方に位置しているかどうかを検出するもので、このセンサの検出信号の出力によりシャッタ9が開閉される。

【0017】 X線照射手段6の下方に設けられた X線の通路8a, 11aの周囲には図示してないが、 X線漏洩防止手段としての遮蔽部材が設けてある。遮蔽部材としては、従来技術と同様な鉛含有の合成樹脂シートを用い、裾の部分に適当な間隔で縦の切れ目を入れた2 牧のシートが並設してある。 プリント基板に X線を照射する際には、内側を密閉することにより遮蔽部材の裾の部分がテーブル上のワークに当って X線が周囲に漏洩しないように遮蔽可能にしてある。

【0018】テーブル1と基板4との間にあって、撮像・穴明けなどの作業が行われるべき位置の近傍には、センサを内臓したワーク受け21が位置している。このワーク受け21にはセンサ18の光を反射するミラーが設けられており、この光をプリント基板4が遮ることにより基板の有無を検出し得るようにしてある。

【0019】次に、このテーブル1の下方に位置する撮像手段2及び穴明け手段3を作業位置へ移動させるXYテーブル機構(移動手段)22について説明する。テーブル1の下方には、図示しない装置本体に支持板23が固着されており、この指示板の上面にはX方向に平行な1対のレール24,25が設けてある。

【0020】図4は、指示板23の上面側の状態を示すもので、指示板23上には、先に述べたレール24,25が設けてあり、これらのレール上にはそれぞれX方向に摺動可能なスライダ26a,26b,26c,26dが取り付けられている。さらにこれらのスライグの上面

5

には、図面の上下方向(Y)方向にガイドされるスライ ダ27a、27b、27c、27dがレールと嵌合する 面を上に向けた状態で固着されている。このスライダ2 6 a ~ 2 6 d と他のスライダ 2 7 a ~ 2 7 d は実質的に 直交する方向に向けて配設してある。

【0021】これらのスライダ26a~27d上に、Y 方向に延びる1対のレール28、29が嵌合されてい る。また支持板23上には、モータ30が取り付けられ ており、このモータの駆動軸と連結されたリードスクリ ュー31が回転自在に設けられている。そしてこのリー 10 明け手段3は、スピンドルモータ3aの駆動によりドリ ドスクリュー31には、ナット32が螺合し、ナット3 2は、ナットホルダ33を介してスライダ26a及び2 7 a に固着されている。従って、モータ30の駆動によ りリードスクリュー31が回転すると、ナット32、ナ ットホルダ33、スライダ26a、27aはX方向に移 動する。この時レール28によりこれに連結されている スライダ26b~26d、27b~27dも一体的に移 動する。

【0022】図4~6に示すように、レール28,29 上には、移動テーブル34が固着されている。この移動 20 -- 48が回転自在に取り付けてある。このリードスクリ テーブル34上には、モータ35が固着されており、こ のモータの駆動軸には、リードスクリュー36が回転自 在に連結してある。リードスクリュー36には、ナット 37が螺合し、このナットはナットホルダ38に固着さ れている。このナットホルダ38は、前述のスライダ2 6 b, 27 bに固着されており、移動テーブル34に対 しては固定されていない。

【0023】この構成において、モータ35の駆動によ りリードスクリュー36が回転すると、ナット37がY 方向に移動しようとするが、ナットホルダ38がスライ ダ26b, 27bに固着されており、スライダ26bは レール25に嵌合されているので、Y方向に移動不能で ある。従って、モータ35の駆動によりリードスクリュ -36が回転しても、ナット37は移動せず、モータ3 5及び移動テーブル34がY方向に移動する。XY機構 22は以上のような構成であるため、移動テーブル34 は、モータ30、35の駆動によりXY方向に移動自在 である。

【0024】次に撮像手段2及び穴明け手段3について してあり、この支持板には連結板40及び筒部材41を 介して撮像手段であるX線カメラ2が保持されている。 X線カメラ2には、後述の画像処理装置や中央処理装置 などが接続されており、プリント基板4の識別マークの 透過像を画像処理した結果に基づいて前述のXYテーブ ル機構22等の動作が制御される。なお、本実施例では X線カメラ2としてビジコンカメラを用いており、これ は比較的安価であるとともに、後述するように穴とマー クとを同時に撮像する際に、ハレーションを起こしにく いものである。

【0025】支持板39の反対側の面には1対の垂直レ ール42, 43が取り付けてある(図5, 7参照)。そ して、穴明け手段3を保持する保持フレーム44に、レ ールガイド(図示略)が設けてあり、このレールガイド

はレール42, 43に摺動自在に嵌合している。

【0026】図3に示すように、穴明け3手段は、スピ ンドルモータ3aとその上端に固着してあるコレットチ ャック3b及びこのコレットチャックに保持されたドリ ル3 c 等の穴明け部材によって構成されている。この穴 ル3 c が回転し、プリント基板 4 を穴明けするものであ る。この穴明け手段3の上端には切り屑を排出するため の切屑カバー45が取り付けてある。

【0027】次に、図7を参照して穴明け手段3を上下 方向(2方向)に駆動する駆動機構について説明する。 なお図7は、構成をわかり易くするために、図5のB-B線で断面にしたものである。

【0028】図示してあるように、支持板39には、取 付け部材47を介して、2方向に延びるリードスクリュ ュー48にはナット49が螺合し、さらにこのナット は、ナットホルダ50を介して前述の保持フレーム44 に固着されている。リードスクリュー48の上端は、ベ ルト車51に連結されている。また、取付け部材47に は穴明け手段の昇降駆動用のモータ52が保持されてお り、モータ52の駆動軸がベルト車53に連結されてい る。従って、モータ52の駆動によりベルト車53が回 転すると、ベルト54を介してベルト車51に回転が伝 達され、それによってリードスクリュー48が回転す る。すると、ナット49と一体的にナットホルダ50、 保持フレーム44に保持されている穴明け手段3を昇降 させる。

【0029】次に図1に示すブロック図を用いて本実施 例におけるX線穴明け装置の制御手段について説明す る。制御手段の中心になるのは、中央処理装置 (CP U) 61であり、この中央処理装置には、その出力信号 を受けて穴明け手段3やXYテーブル機構22が有機的 に動作可能になるように接続されている。また、X線照 射手段6もこの中央処理装置61によって制御されるも 説明する。移動テーブル34上には、支持板39が立設 40 のであり、照射されたX線がワークを透過し、このワー クに付けられたマークの透過像や穴明けされた穴をX線 カメラ2によって撮像可能に設けてある。X線カメラ2 には画像処理装置62が接続してあり、この画像処理装 置は処理したデータを出力可能に中央処理装置61に接 続されている。中央処理装置61には、上記両データか ら両者間の座標位置のずれを算出する演算回路63及び 識別マークの位置座標や穴明け位置の位置座標のデータ などを記憶する記憶回路64がデータ信号を交換可能に 接続してある。なお、中央処理装置61には、ディスプ 50 レイなどの出力装置 65 が接続されており、座標位置等

は常時モニターできるようにしてある。出力装置65は 必要に応じてプリンタなどの記録手段を備え付けること も可能である。

【0030】次に、本発明によってプリント基板の所定 位置に穴明けする要領について、図8に示すフローチャ ートに沿って説明する。穴明け作業に先立って、ワーク であるプリント基板4をテーブル1上にセットする(7 1)。そこで、未加工のプリント基板に付された識別マ ークの位置を画像認識により検出して穴明け位置を決定 する。まずХҮテーブル機構22のモータ30、35の 10 駆動により移動テーブル34を移動させ、X線カメラ2 をテーブル1の孔部1a及びプリント基板4を介して、 X線照射手段6のX線の通路8a, 11aと対向する作 業位置に移動させる。次に、保護筒昇降用のシリンダ 1 ' 4のシリンダロッド14aを伸長させ、保護筒11を下 降させる (図2、3参照)。

【0031】ここで、センサ18によりプリント基板4 の存在を確認した後、シャッタシリンダ10の駆動によ りシャッタ9を開けると、X線の通路8a, 11aが防 護管8のX線の出口と連通する(図3参照)ので、X線 照射手段6からX線がプリント基板4を透過可能であ る。プリント基板4に設けられた識別マークの透過像 は、テーブル1の下方に設けられたX線カメラ2によっ て撮像され、画像処理装置62に送られる(図1参 照)。

【0032】次にモニター65を見ながら画像認識によ りプリント基板4の位置を調整しつつ識別マークの位置 を、モニターの中央部に設けられた計測領域を示す枠内 にくるように合わせ込み、フットスイッチ(図示略)を 押す。これにより、シリンダ14を駆動して、そのシリ ンダロッド14aを伸長させ、連結部材15を介して保 護筒11を下降させる。保護筒15の下端部をプリント 基板4の上面に当接し、これをテーブル1の上面に押さ え付けて合わせ込まれた位置に保持する。

【0033】ここでX線カメラ2によって識別マークの 透過像が撮像される(72)。撮像された識別マークの 画像は画像処理装置62に出力されて画像処理される。 得られた画像データは中央処理装置61に出力され、演 算回路63によりマークの中心位置が算出される(7 3)。識別マークの中心位置が算出されると、中央処理 40 装置61からの指示により、XYテーブル機構22のモ ータ30,35が駆動し、穴明け手段3をX方向及びY 方向に移動させ、穴明け手段のドリル3cの先端を穴明 けマークの中心に合うように位置合わせ (74) が行わ れる。

【0034】次に、穴明け手段3の昇降駆動用のモータ 52が始動して、スクリュー49によって保持フレーム 44を介して穴明けスピンドルモータ3aによってドリ ル3cを回転させてプリント基板4に穴明けする(7

3参照)から排出される。穴明け作業後に、シリンダ1 4 を駆動して保護筒11を後退させて元の位置に復帰す

【0035】穴明け作業が終わると、識別マーク及び明 けられた穴は、X線カメラ2によって同時に撮像される (76)。図9に示すように、モニター65の視野(X 線カメラの撮像範囲内)65aに、識別マークの透過像 M及び明けられた穴の画像Hが写し出される。ここで は、両画像M、Hの中心座標は、多少ずれていてそれぞ れM1, H1に位置しているものとして説明を進める。 ここで撮像された両画像は、画像処理装置62に送ら れ、ここで画像処理され、その画像信号は中央処理装置 61に出力される。なお、本実施例では、穴の内部とマ ーク印刷部と基板の地肌部との 3 種類の画像の区別をす るため、通常の2値化ではなく、いわば3値化とも言う べき処理を行ない、これら3ヶ所の色の濃淡を区別して いる。

【0036】識別マークと明けられた穴の両画像M, H の画像データは、中央処理装置61を経て演算回路63 で中心座標M1, H1の位置が比較(77)される。こ の結果、x 座標のずれ量 (x 1 - x 2) 及び v 座標のず れ 量 (y 1 - y 2) の値が算出され、補正データが作成 される(78)。この補正データは、記憶回路64に記 憶され、次の回からの穴明け作業におけるデータとして 利用に供される。従って、以後の穴明け作業における穴 明けのための位置決めは、穴明け後に同時に撮像された 識別マーク及び明けられた穴の中心座標の位置から割り 出された数値によって補正されるので、穴明け位置の精 度が向上する。

【0037】このように穴と識別マークとを穴明け後に 同時に撮像して補正データを作成する作業は、穴明け機 製造時に1回だけ行なっておけば、その後ユーザーが穴 明けを行なう際に繰り返し行なう必要はない。もちろ ん、穴明け毎に上記作業を行ない補正データを更新する ようにしてもよい。

【0038】なお本実施例では、穴明け手段としてドリ ルの回転によって穴を明ける一種のボール盤を用いてい るが、これに限られるものではなく、パンチングその他 の穴明け手段でもよい。また、ワークはプリント基板に 限らずX線が透過可能な板材一般に適用可能である。

【発明の効果】本発明は、X線を用いて穴明けを行なう 場合に、穴明け後に識別マークと明けられた穴とを同時 に撮像し、得られた画像データから両者の中心座標の位 置ずれを演算することにより、穴明け時などにプリント 基板が移動することがあっても、それに左右されず正確 なずれ量の算出が可能となるので、これに基づいて補正 を行なってプリント基板の穴明けの精度が向上する。ま たこのずれ量を補正データとして記憶して、以後の穴明 5)。 穴明けにより生じた切り屑は切屑カバー 45 (図 50 け作業にこの補正データを利用可能となるので、常に正 9

確な位置に穴明けすることが可能になる。

【0040】したがって、本発明によると、穴明けの正確な位置決めが極めて容易になるので、プリント基板の 穴明け作業の能率が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るX線穴明け装置のブロック図であ ろ

【図2】本発明の構成の要部を示す右側面の断面図である。

【図3】図2のA-A線断面図である。

【図4】 XYテーブル機構の移動テーブル以下の構成を示す平面図である。

【図5】XYテーブル機構の平面図である。

【図6】XYテーブル機構の左側面図である。

【図7】図5のB-B線断面図である。

10 【図8】本発明における穴明け方法のフローチャートである。

【図9】撮像画面の平面図である。

【符号の説明】

2 撮像手段(X線カメラ)

3 穴明け手段

4 プリント基板 (ワーク)

6 X線照射手段

22 XYテーブル機構

) 61 中央処理装置

62 画像処理装置

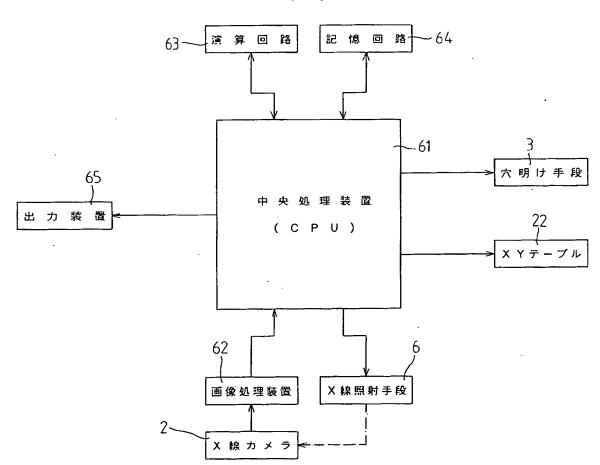
63 演算回路

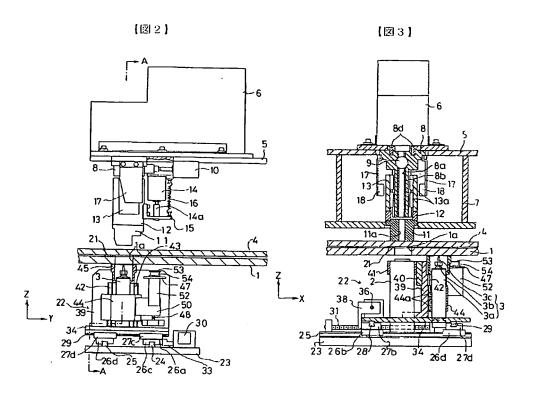
64 記憶回路

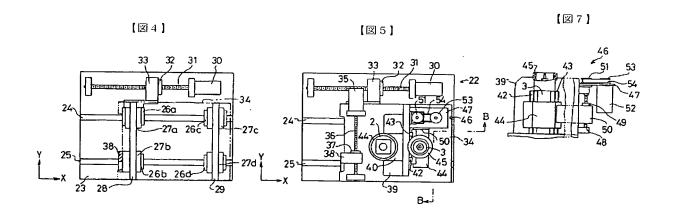
M 識別マークの透過像

H 穴の画像

【図1】







Z 35 36 37 39 38 27b 23 260 24 270 26b

[図6]

